

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】令和5年5月23日(2023.5.23)

【国際公開番号】WO2022/044879

【出願番号】特願2022-544472(P2022-544472)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/09(2006.01)

G 0 3 F 7/004(2006.01)

G 0 3 F 7/027(2006.01)

B 3 2 B 27/00(2006.01)

G 0 6 F 3/041(2006.01)

10

【F I】

G 0 3 F 7/09 5 0 1

G 0 3 F 7/004 5 1 2

G 0 3 F 7/027

B 3 2 B 27/00 B

G 0 6 F 3/041 4 0 0

G 0 6 F 3/041 4 9 5

20

【手続補正書】

【提出日】令和5年2月13日(2023.2.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

仮支持体と、前記仮支持体上に配置された感光性組成物層とを有する長尺状の転写フィルムであって、

前記仮支持体の長手方向の100における貯蔵弾性率 E_{a2} に対する、前記仮支持体の短手方向の100における貯蔵弾性率 E_{a1} の比が、1.40以下である、転写フィルム。

30

【請求項2】

式(1)で求められる X が、7.00%以下である、請求項1に記載の転写フィルム。

$$X = \{ [(E_{b1} / E_{b2}) - (E_{a1} / E_{a2})] / (E_{b1} / E_{b2}) \} \times 100$$

式(1)

E_{a1} ：前記仮支持体の短手方向の100における貯蔵弾性率(GPa)

E_{a2} ：前記仮支持体の長手方向の100における貯蔵弾性率(GPa)

E_{b1} ：前記仮支持体の短手方向の80における貯蔵弾性率(GPa)

E_{b2} ：前記仮支持体の長手方向の80における貯蔵弾性率(GPa)

40

【請求項3】

前記仮支持体の100における短手方向の貯蔵弾性率 E_{a1} と、前記仮支持体の100における長手方向の貯蔵弾性率 E_{a2} との相乗平均が、1.00GPa以上である、請求項1又は2に記載の転写フィルム。

【請求項4】

前記仮支持体の厚みが、40.0 μ m以下である、請求項1～3のいずれか1項に記載の転写フィルム。

【請求項5】

50

前記感光性組成物層の厚みが、 $20.0\ \mu\text{m}$ 以下である、請求項1～4のいずれか1項に記載の転写フィルム。

【請求項6】

前記感光性組成物層が、バインダーポリマー、重合性化合物、及び、重合開始剤を含む、請求項1～5のいずれか1項に記載の転写フィルム。

【請求項7】

前記感光性組成物層上に配置された屈折率調整層を更に有する、請求項1～6のいずれか1項に記載の転写フィルム。

【請求項8】

前記感光性組成物層が、タッチパネル用電極保護膜形成に用いられる、請求項1～7のいずれか1項に記載の転写フィルム。 10

【請求項9】

前記仮支持体は、中間層の表裏に外層が積層されたものである、請求項1～8のいずれか1項に記載の転写フィルム。

【請求項10】

前記仮支持体上に前記感光性組成物層が形成されてなる、請求項1～9のいずれか1項に記載の転写フィルム。

【請求項11】

前記仮支持体の厚みは、 $30.0\ \mu\text{m}$ 以下である、請求項1～10のいずれか1項に記載の転写フィルム。 20

【請求項12】

請求項1～11のいずれか1項に記載の転写フィルムの前記仮支持体とは反対側の表面を、被転写体に貼り合わせ、前記被転写体、前記感光性組成物層、及び、前記仮支持体をこの順に有する感光性組成物層付き被転写体を得る貼合工程と、

前記感光性組成物層をパターン露光する露光工程と、

露光された前記感光性組成物層を現像して、パターンを形成する現像工程と、を有し、更に、前記貼合工程と前記露光工程との間、又は、前記露光工程と前記現像工程との間に、前記感光性組成物層付き被転写体から前記仮支持体を剥離する剥離工程と、を有する、積層体の製造方法。

【請求項13】 30

請求項1～11のいずれか1項に記載の転写フィルムの前記仮支持体とは反対側の表面を、導電層を含む被転写体に貼り合わせ、前記被転写体、前記感光性組成物層、及び、前記仮支持体をこの順に有する感光性組成物層付き被転写体を得る貼合工程と、

前記感光性組成物層をパターン露光する露光工程と、

露光された前記感光性組成物層を現像して、パターンを形成する現像工程と、

前記パターンが配置されていない領域における前記導電層をエッチング処理するエッチング工程と、

更に、前記貼合工程と前記露光工程との間、又は、前記露光工程と前記現像工程との間に、前記感光性組成物層付き被転写体から前記仮支持体を剥離する剥離工程と、を有する、回路配線の製造方法。 40

【請求項14】

前記被転写体が、段差を有する基板である、請求項12に記載の積層体の製造方法。